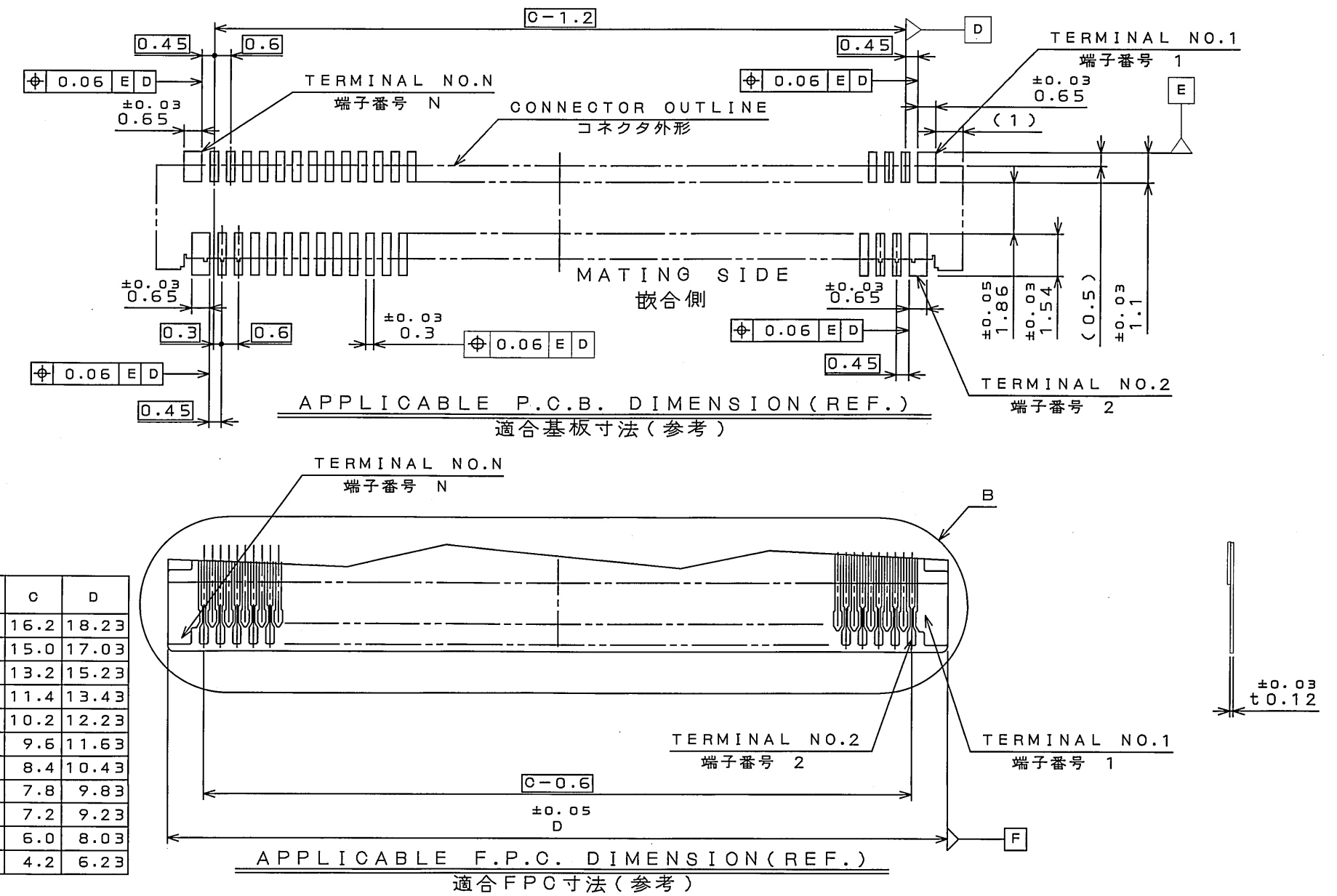
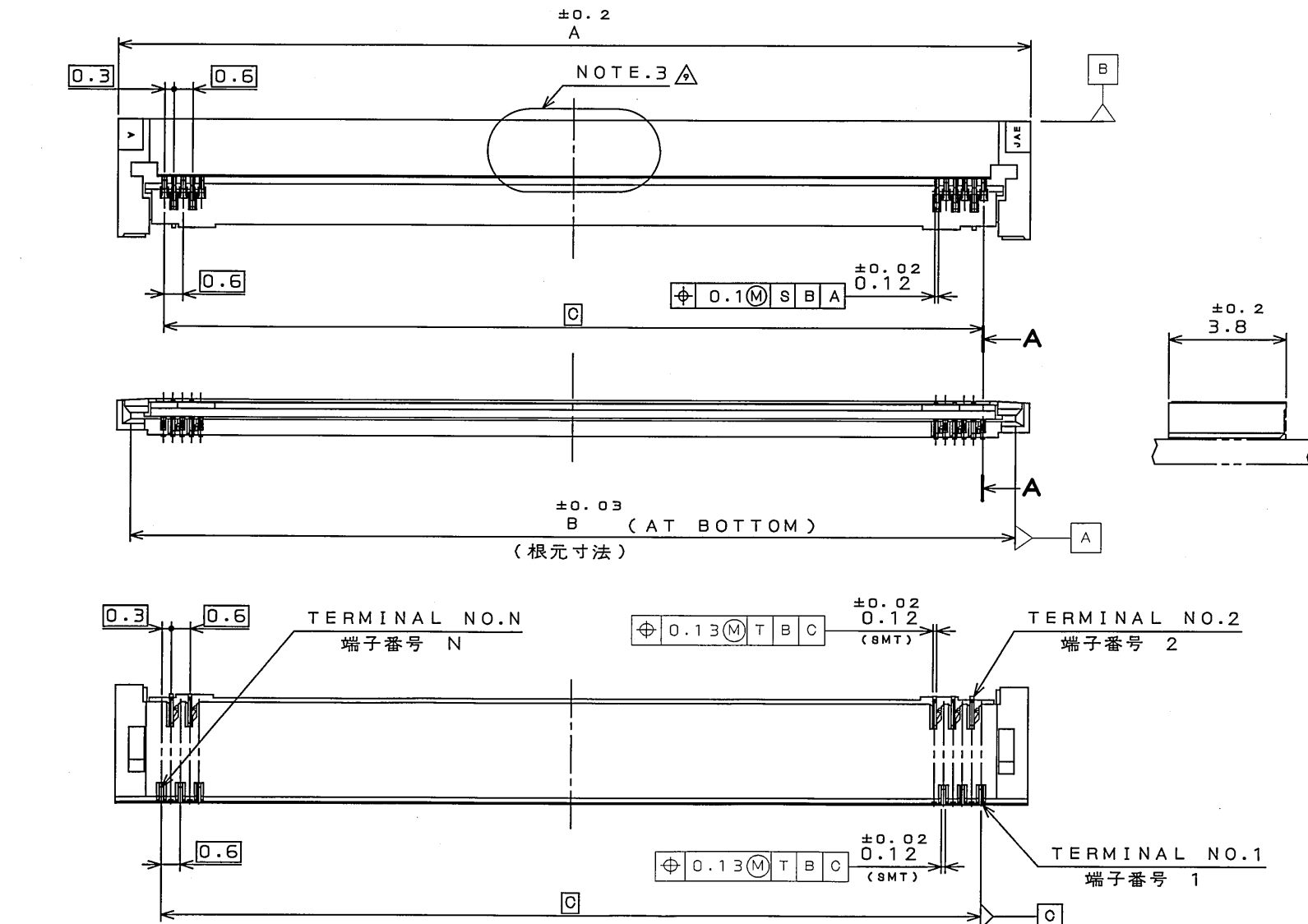
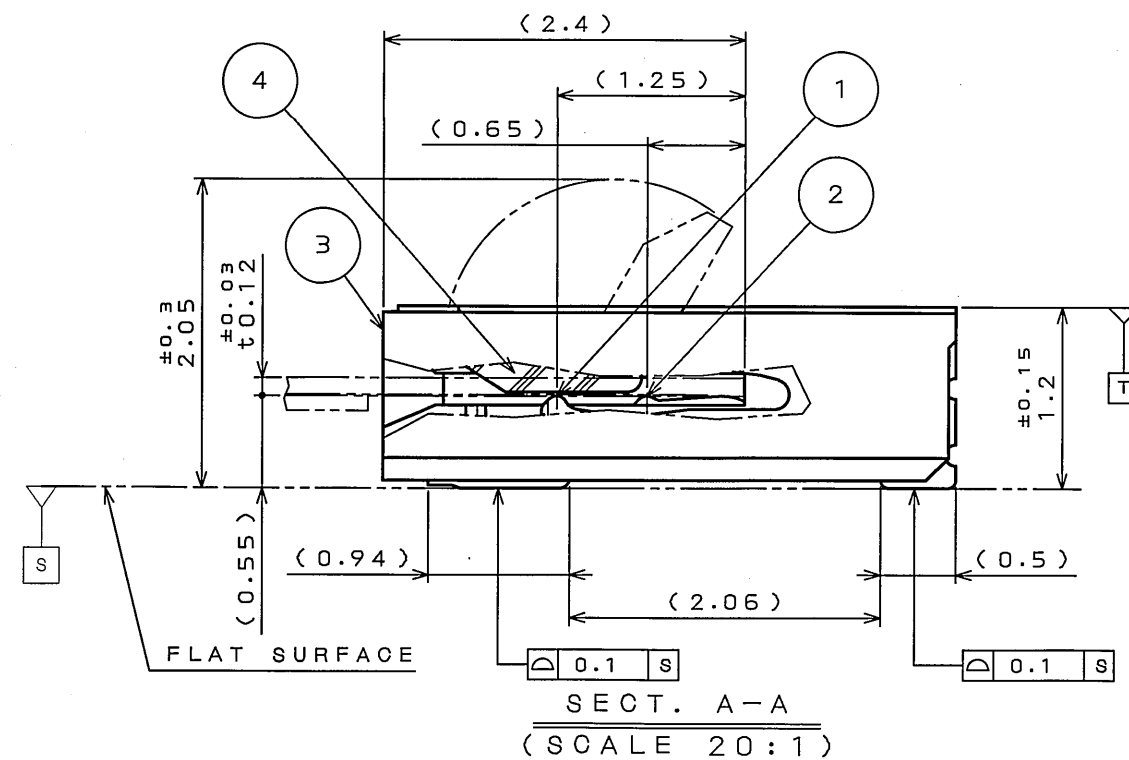


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
9	15.Feb.2005	056722	ADDED LOT NUMBER RE-DRAW		K.INOUE		O.Hashiguchi



PRODUCT NO. 品名	A	B	C	D
FF0255881	19.2	18.31	16.2	18.23
FF0251881	18.0	17.11	15.0	17.03
FF0245881	16.2	15.31	13.2	15.23
FF0239881	14.4	13.51	11.4	13.43
FF0235881	13.2	12.31	10.2	12.23
FF0233881	12.6	11.71	9.6	11.63
FF0229881	11.4	10.51	8.4	10.43
FF0227881	10.8	9.91	7.8	9.83
FF0225881	10.2	9.31	7.2	9.23
FF0221881	9.0	8.11	6.0	8.03
FF0215881	7.2	6.31	4.2	6.23



DESIGNATION

命名法
FF02 * * SS1

CONTACT FINISH
(1:GOLD OVER NICKEL(Au:0.1μm MIN))
コンタクトめっき仕様 (1:ニッケル上金めっき(Au:0.1μm以上))
MODIFICATION S:NICKEL BARRIER
モディファイ ニッケルバリア
CONNECTOR FORM (S:SOCKET)
コネクタ形状 (S:ソケット)
NO. OF CONTACTS (N) (NOTE 1)
芯数 (N) (注1)

TABLE 2

COMPOSITION 層名	THICKNESS(EXAMPLE) 厚さ(例)	NOTE 備考
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 0.3~0.6μm	0.1μm MIN
NICKEL PLATING ニッケルめっき	ELECTROLYSIS PLATING 3~9μm	SOFT TYPE IF AVAILABLE
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 18μm	NOMINAL 18μm MAX
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	NONE (RECOMMENDED)
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE 25μm	25μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	30μm MAX
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE 12.5μm	-

NOTE 1. REFER TO THE DRAWING SJ036196 FOR EVEN NUMBER OF CONTACTS.
NOTE 2. FPC COMPOSITION (RECOMMENDED) REFER TO TABLE 2
NOTE 3. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP CENTER PORTION OF THE CONNECTOR.

注1.偶数芯数のコネクタ寸法は SJ036196 参照。
注2.FPC構成(推奨)TABLE2 参照。
注3.ロット番号がコネクタ上面中央部に表記される。

4	ACTUATOR アクチュエータ	1	PPS		COLOR:BLACK/色相:黒 UL94V-0
3	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	LCP		COLOR:WHITE/色相:白 UL94V-0
2	CONTACT 2	(N-1) 2	COPPER ALLOY 銅合金		PARTIAL GOLD OVER NICKEL(Au:0.1μm MIN.) ニッケル上部分金めっき(Au:0.1μm 以上)
1	CONTACT 1	(N+1) 2	COPPER ALLOY 銅合金		PARTIAL GOLD OVER NICKEL(Au:0.1μm MIN.) ニッケル上部分金めっき(Au:0.1μm 以上)
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
	仕様書(SPECIFICATION) JACS-1627 JAH-1627	第1版(ORIGINAL DATE) 1.Aug.2001	製図 DR.	シリーズ(SERIES) FF02	日本航空電子工業株式会社
	公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)	製図 CHK.	担当 APPD.	名称(TITLE) FF02 * * SS1	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
	. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±	製図 CHK.	承認 APPD.	図面番号(DRAWING NO.) SJ036197	図面番号(DRAWING NO.) SJ036197



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.